

半導体パッケージの微細化、平坦化、信頼性向上に貢献 感光性ポリイミド材料 **ZEMATES**™

お客様と共に未来の半導体業界を支え、
イノベーションを生み出す“信頼できるパートナー（仲間）”であり続けたい

感光性ポリイミドの製品ロードマップ

Advanced RDL dielectric for WLP/PLP

180-250° C Cure
NMP/NEP フリー
PFAS フリー
高解像性 (>5um Via)



Advanced Buffer coat layer

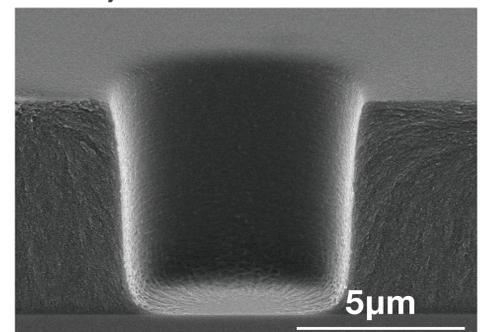
300-400° C Cure
NMP/NEP フリー



液タイプ感光性ポリイミド

- 幅広い機械特性/熱特性により、様々な再配線層への適用が可能
- 高解像性能により、配線微細化に貢献
- 先端パッケージに適用可能な高信頼性を実現

Ex) 5um Via/6.5um FT



フィルムタイプ感光性ポリイミド

- ラミネートプロセスによる高平坦性で再配線層の多層化に寄与
- パネルプロセスでの生産性向上に貢献
- 先端パッケージに適用可能な高信頼性を実現

Ex) 7um Via/10um FT

